

株式会社バイ・テクノロジー

2024年3月期(第27期) 中間決算

補足説明資料

2023年11月10日

2024年3月期 第2四半期決算の要旨

▶ 上期の売上・利益は、期初計画を上回る着地

- ▶ 主に、Q3計上予定の高利益率な大型案件の前倒し計上による

▶ Q3(3か月)は、今期Q2比で増収減益

- ▶ 上記案件前倒し、ミックス悪化によりQ3が底となる見通し
- ▶ Q4売上は4年振りに200億円を越す計画であるが、期初計画通りの進捗であり、予想の修正無し

▶ 装置受注と受注残は、共に増加

- ▶ 半導体・フォトマスク装置事業の受注残は、過去最高を更新、FPDも健闘
- ▶ レガシー～成熟ノードの半導体製造トータルで対応可能なフォトマスク用検査装置群
- ▶ 4月新設の合併会社LE-TEHCNOLOGYが、アドバンスドパッケージ用DIを受注

▶ 自己株式の取得を決議

- ▶ 注力事業の進捗等を踏まえ来期からの業績回復を見込む中で、現在の株価水準は、資本効率の向上および株主還元を行うにあたり最適
- ▶ 取得価額の総額500百万円/取得株式数の上限238,000株(発行済み株式数の2.43%)
- ▶ 取得期間11月13日(月)～12月29日(金)/東証における市場買付
- ▶ 2024年5月に中期経営計画の公表を予定

| 第2四半期決算

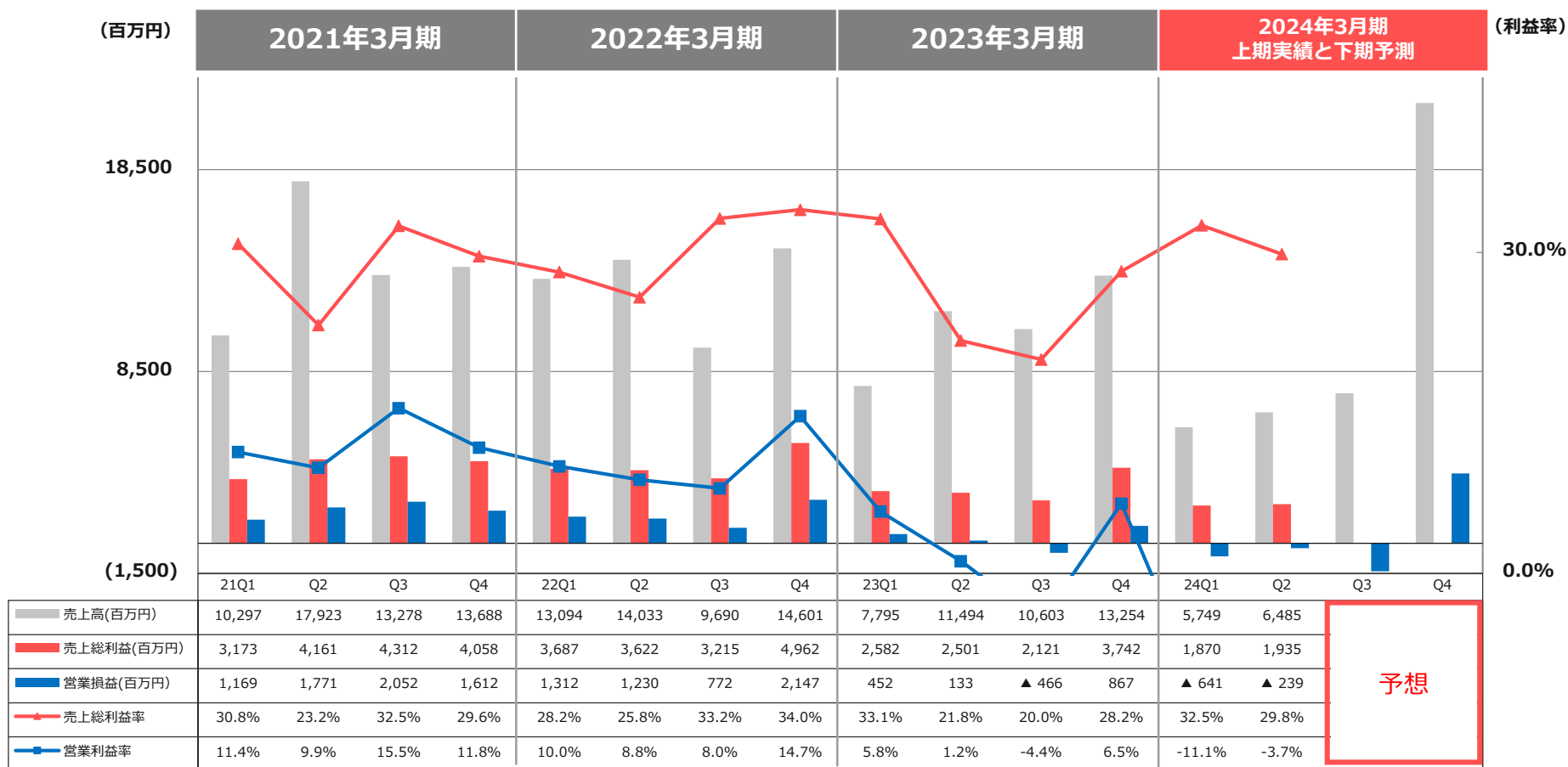
全社連結業績サマリー

- ▶ 主にFPD装置需要の低迷から、前期比で減収減益
- ▶ Q3の高利益率な大型案件の前倒し等により、上期損失は想定より縮小

(百万円)	2023年3月期上期		2024年3月期上期		
	金額	構成比	金額	構成比	前年同期比
売上高	19,289	100.0%	12,334	100.0%	▲36.1%
売上総利益	5,083	26.4%	3,805	30.8%	▲25.1%
営業利益(損失▲)	585	3.0%	▲880	—	—
経常利益(損失▲)	1,530	7.9%	▲592	—	—
親会社株主に帰属する四半期純利益(損失▲)	1,330	6.9%	▲647	—	—

四半期毎連結売上高・利益の推移実績と予想

- ▶ Q2は、Q3からの高利益率な大型案件の前倒しで損失縮小
- ▶ Q3は、上記により損失が拡大
- ▶ Q4は、4年振りに売上高が200億円超となる反転回復を予想(期初計画通りの進捗)
 - ▶ (参考)四半期最大売上：2018年3月期Q4:248億円
- ▶ 通期業績予想の修正無し



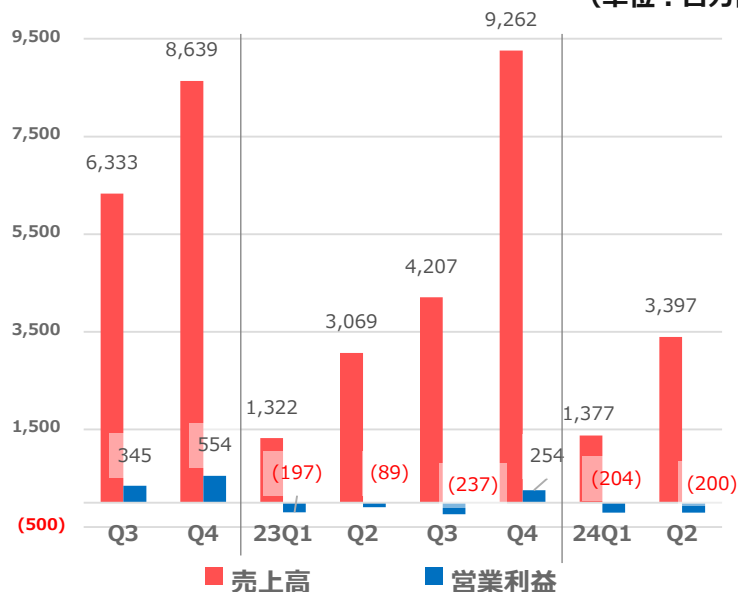
予想

各セグメントの連結売上高・営業利益の状況

- ▶ 半導体フォトマスク：前年同期比増収ながら、合併会社立上げ費用等の増加により、利益は減少
- ▶ FPD：高利益率な大型案件の前倒し計上により、期初想定より損失が縮小

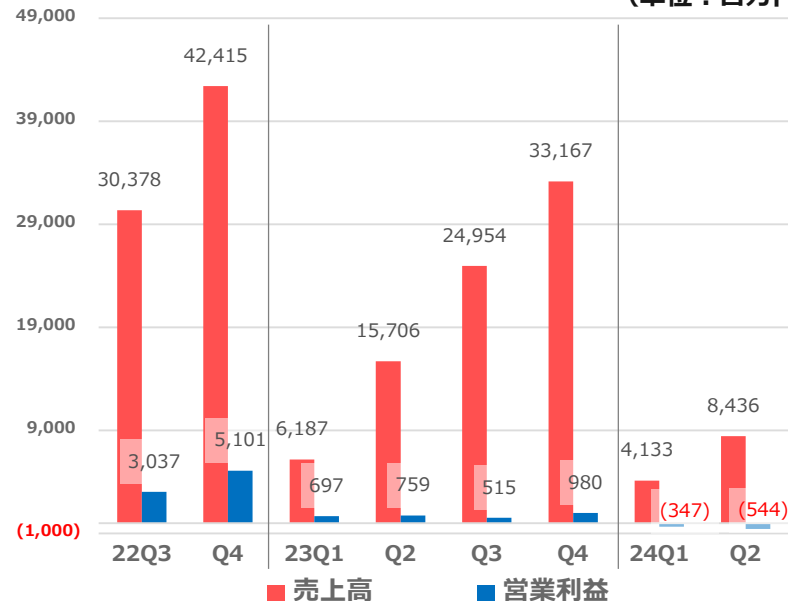
半導体・ フォトマスク* ₁	23年3月Q2	24年3月Q2	YoY
売上高	3,069	3,397	+10.7%
営業利益(損失▲) (セグメント利益率)	▲89 (-%)	▲200 (-%)	-%

(単位：百万円)



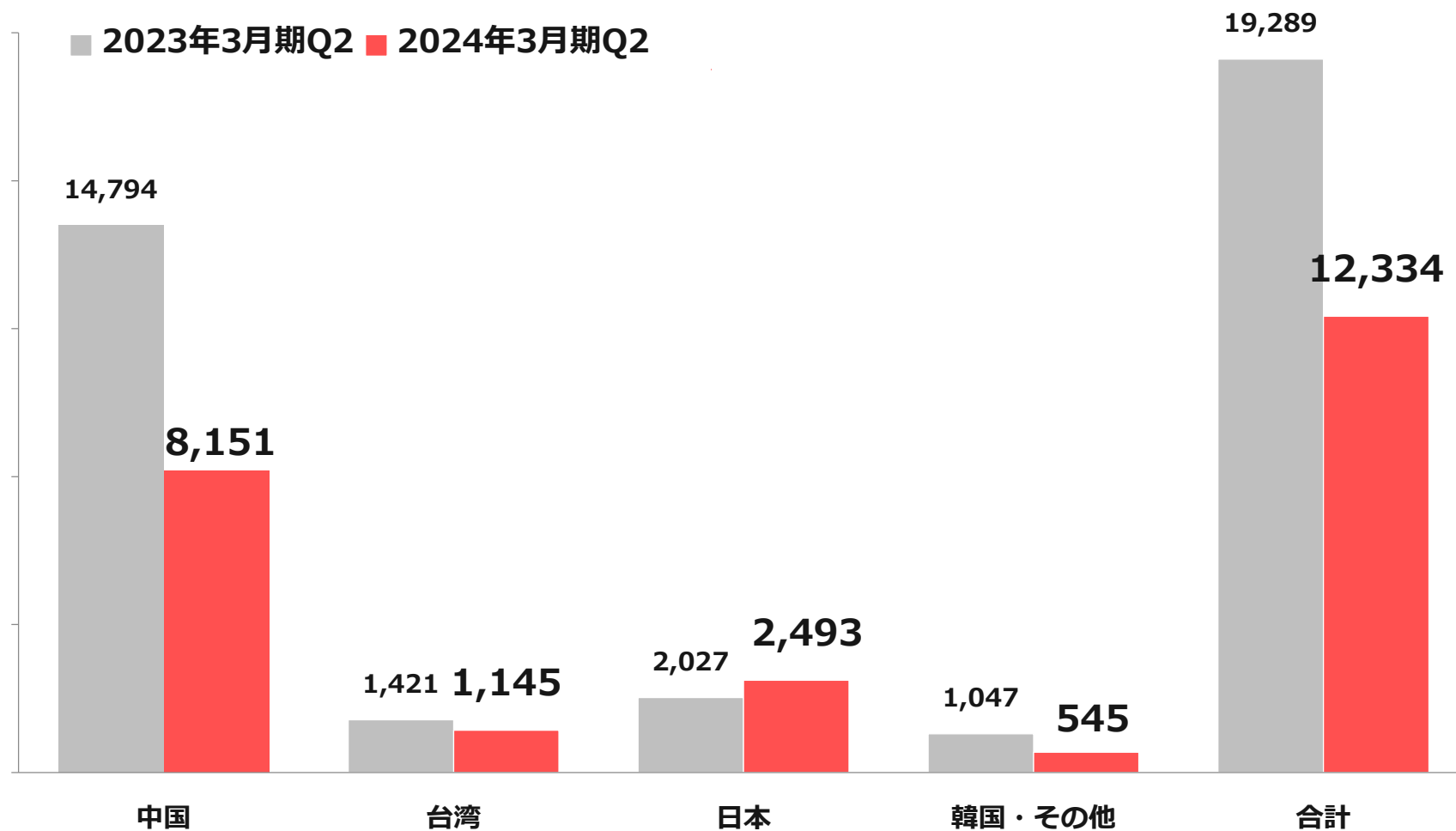
FPD* ₂	23年3月Q2	24年3月Q2	YoY
売上高	15,706	8,436	▲46.3%
営業利益(損失▲) (セグメント利益率)	759 (4.8%)	▲544 (-%)	-%

(単位：百万円)



*1 半導体・フォトマスク装置事業：半導体製造工程における製造装置、検査装置及びフォトマスク用装置等の開発・設計・製造・販売・関連サービス、及びPCB用装置で構成
 *2 FPD装置事業：FPD製造工程における製造装置、検査装置等の開発、設計、製造、販売、関連サービス及びOLED用蒸着マスクをはじめとする部材等で構成

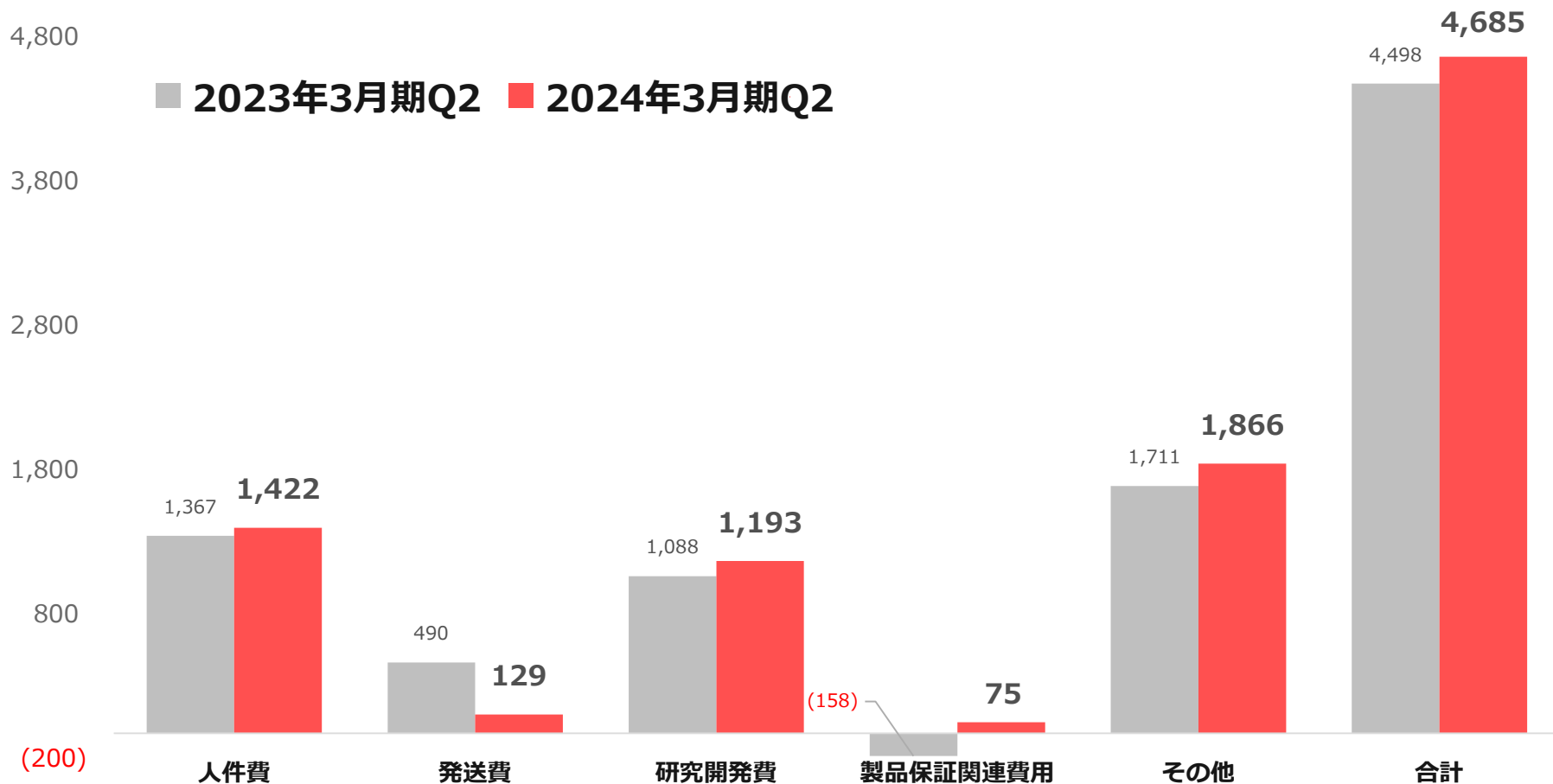
(参考) 地域別連結売上高 (単位: 百万円)



販売費及び一般管理費

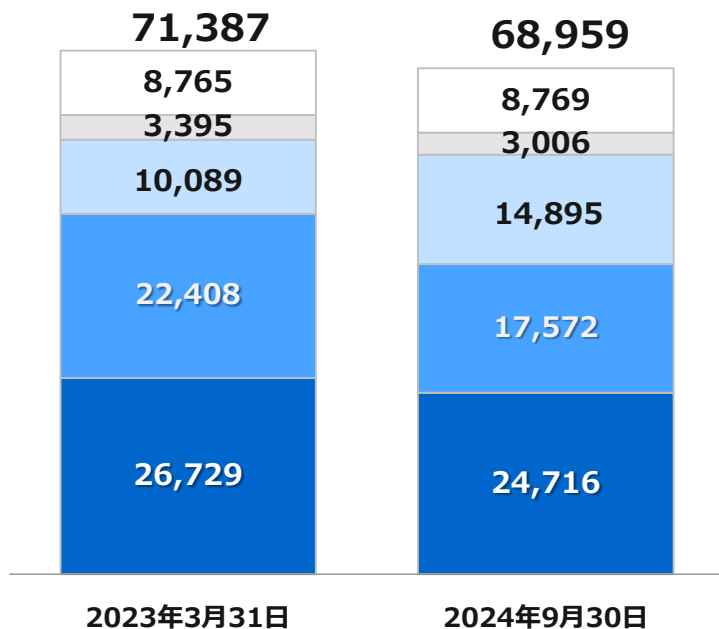
(単位：百万円)

▶ 製品保証引当金前期マイナス、製品開発強化、対面の販促活動増等で前期比+187百万



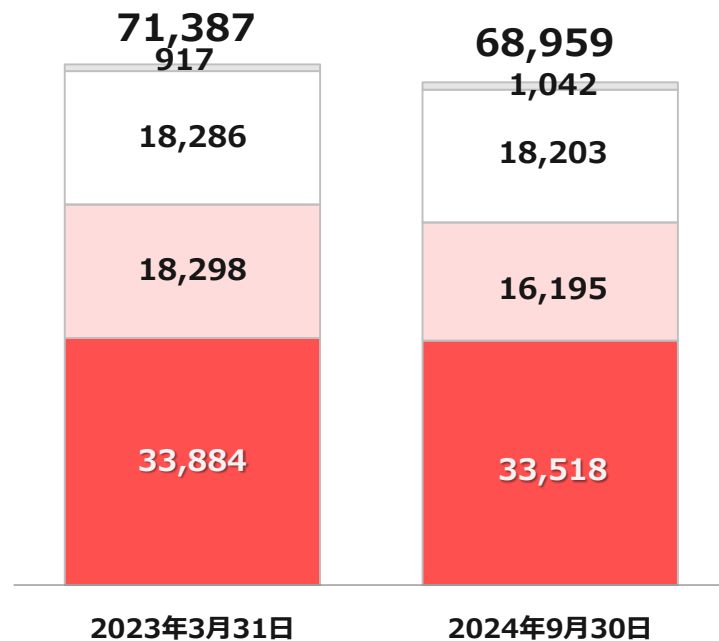
連結貸借対照表

総資産
(単位：百万円)



■ 現金及び預金 ■ 受取手形及び売掛金 ■ 棚卸資産
■ その他流動資産 ■ 固定資産

負債・純資産
(単位：百万円)



■ 純資産 ■ その他流動負債
■ 借入金（短期・長期） ■ その他固定負債

連結キャッシュフロー

- ▶ 営業CF：下期売上関連の仕掛増および前受金の減少等により▲1,568百万円
- ▶ 投資CF：合併会社設立に伴う資産の取得および出資等により▲418百万円
- ▶ 財務CF：長期借入金の返済等より▲219百万円

金額単位：百万円		23年3月期Q2	24年3月期Q2
営業活動による キャッシュフロー	税金調整前純利益	2,016	▲570
	売上債権（増加▲）	1,802	4,939
	棚卸資産（増加▲）	▲4,799	▲4,761
	仕入債務（減少▲）	770	2,182
	前受金（減少▲）	2,860	▲3,726
	その他	▲559	497
	Total	2,090	▲1,568
投資活動によるキャッシュフロー Total		▲422	▲418
財務活動による キャッシュフロー	借入による収入	2,552	3,668
	返済による支出	▲1,951	▲3,758
	その他	▲554	▲129
	Total	47	▲219
現金及び現金同等物に関わる換算差額		648	173
現金及び現金同等物の増減額（減少▲）		2,364	▲2,032
現金及び現金同等物の機首残高		27,778	26,295
現金及び現金同等物の四半期末残高		30,142	24,263

通期業績及び配当予想

- ▶ 現時点で、通期業績および配当の予想の変更無し
 - ▶ 上記案件前倒し、ミックス悪化によりQ3が底となる見通し
 - ▶ Q4売上は、4年振りに200億円を越す計画であり、現在期初計画通りの進捗で予想の修正無し

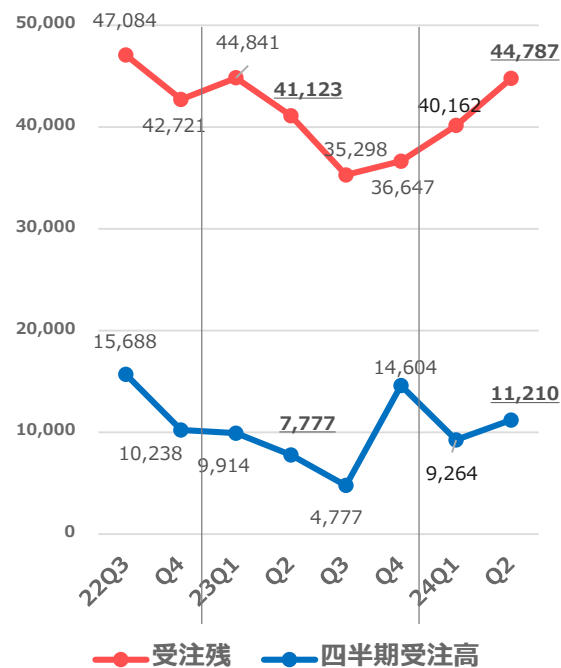
(百万円)	2023年3月期実績		2024年3月期 業績および配当の予想 (2023/5/12時点から変更無)		
	金額	構成比	金額	構成比	前期比
売上高	43,146	100.0%	40,000	100.0%	▲7.3%
営業利益	986	2.3%	1,000	2.5%	+1.4%
経常利益	1,700	3.9%	850	2.1%	▲50.0%
親会社株主に 帰属する当期純利益	260	0.6%	550	1.4%	+111.3%
EPS(円)	26.92		56.88		—
配当(円)	中間	60円	30円(12月支払開始予定)		▲30円
	期末	30円	30円(予想)		—

受注の状況：半導体・フォトマスク装置事業が第2の柱として成長

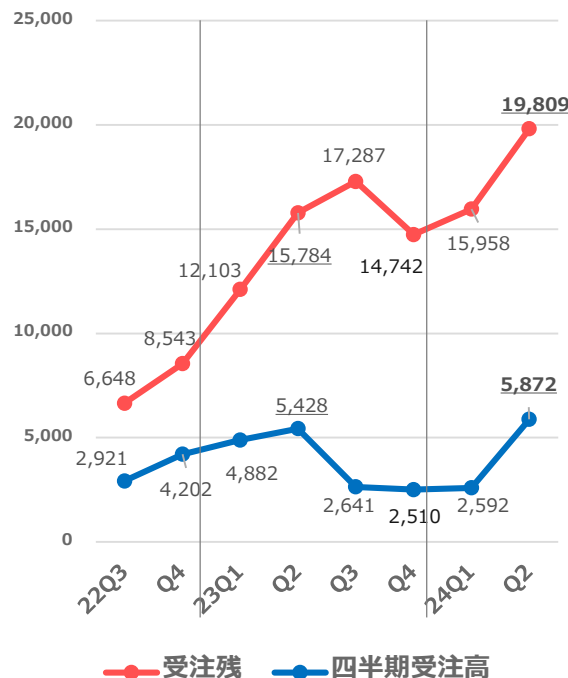
▶ 受注は、半導体関連が牽引し、Q1比で+20%の増加

▶ 半導体・フォトマスク装置事業の受注残は過去最高水準(注残内44%(前期比+6%))

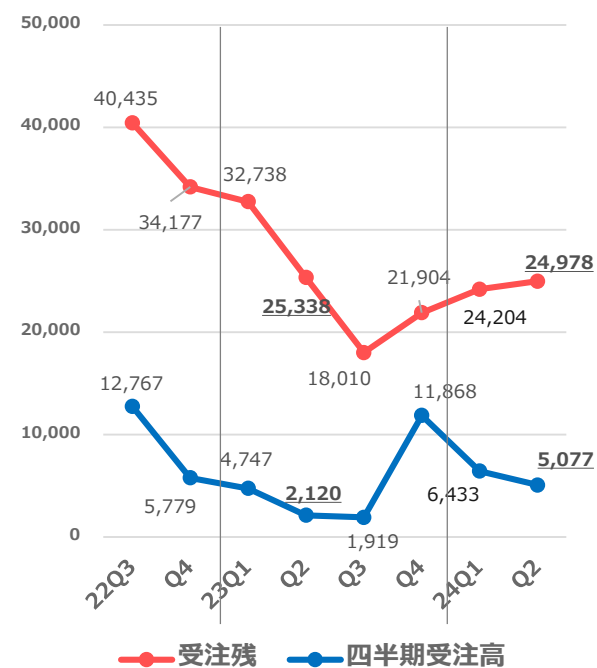
全社	23年Q2	24年Q2	YoY
受注(3カ月)	7,777	11,210	+44.1%
受注残	41,123	44,787	+8.9%



半導体・フォトマスク	23年Q2	24年Q2	YoY
受注(3カ月)	5,428	5,872	+8.2%
受注残	15,784	19,809	+25.5%



FPD	23年Q2	24年Q2	YoY
受注(3カ月)	2,120	5,077	+139.5%
受注残	25,338	24,978	▲1.4%

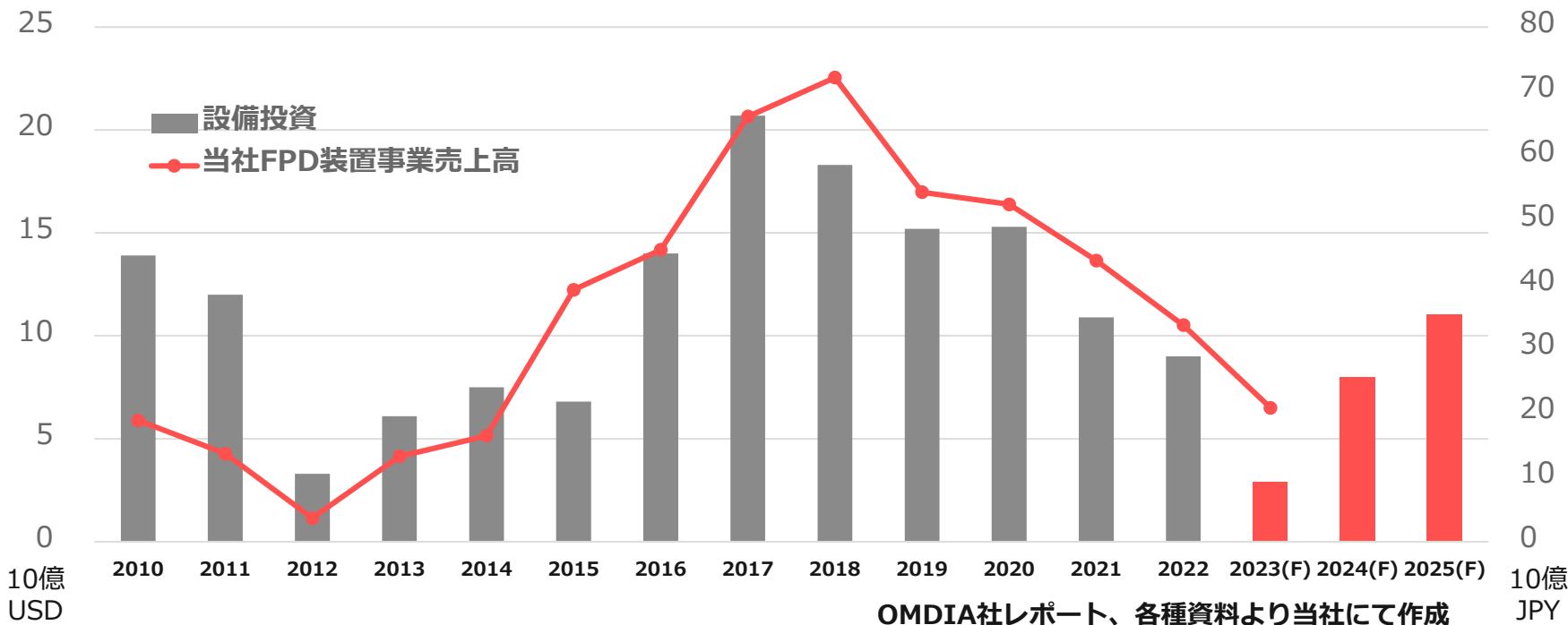


(単位：百万円)

自社株買いを実施

- ▶ **注力事業の進捗等を踏まえ来期以降の業績回復を見込む中、現状の株価水準は、資本効率の向上および株主還元の実施に最適と判断**
 - ▶ 来期以降、主業のFPD装置事業の市況改善が業績回復を後押し
- ▶ **上限株数238,000株/上限総額5億円/契約期間11月13日~12月29日**
 - ▶ 自己株式除く発行済み株式数の2.43%
- ▶ **2024年5月に中期経営計画を公表予定**

FPD設備市場と当社FPD装置事業の売上推移



| トピックス

半導体・フォトマスク装置事業

- ▶ 受注残が過去最高を更新
- ▶ M&Aで加入した事業とVTのFPD技術の展開

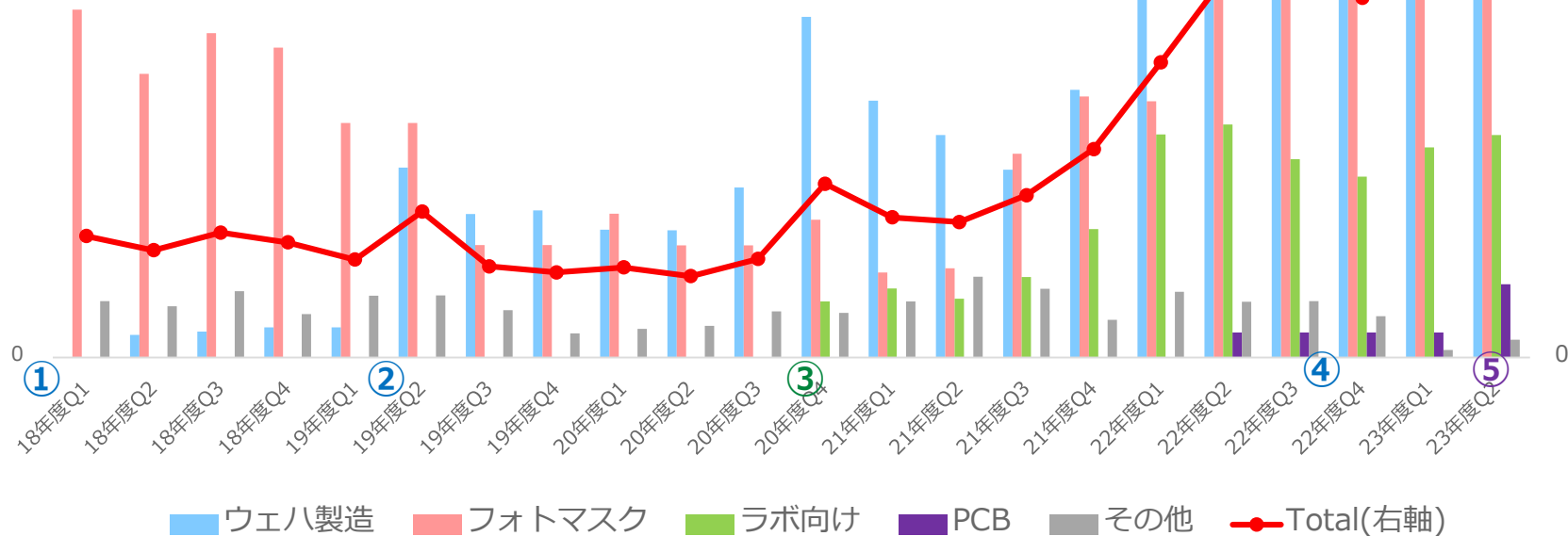
9,000 30,000

半導体・フォトマスク装置事業受注残推移(用途別/百万円)

(参考)M&Aおよび新会社設立の時期

- ①Z-CSET(ウェハ研磨)
- ②ナノシステムソリューションズ(ウェハ/検査)
- ③リソテックジャパン(ラボ用/コーデベ・他)
- ④ジャパנקリエイト(ウェハ/洗浄・他)
- ⑤LE-TECHNOLOGY(PCB/DI露光)

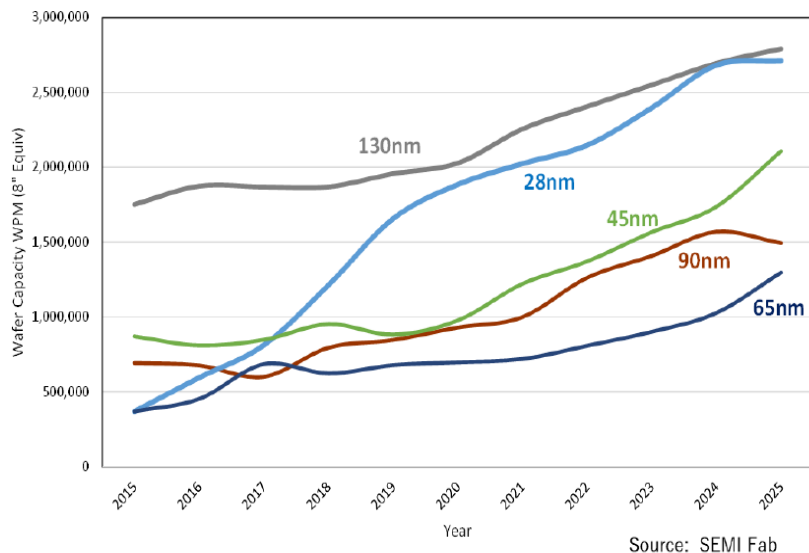
4,500 15,000



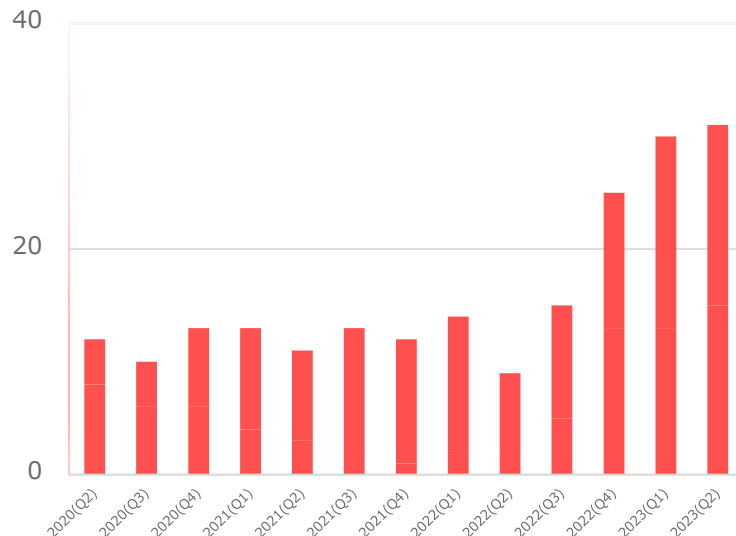
フォトマスク用装置の需要拡大

- ▶ レガシー半導体の生産能力の増強が中国と国内外で継続(図1・2)
- ▶ FPD用装置を母体に半導体用に進化した検査・修正・測定・描画装置を展開(図3)
- ▶ HTL社と協業し国内外の市場を開拓し更なるシェアの拡大を目指す

(図1)デザインルール別生産能力推移予想



(図2)主要レーザー描画装置の市場規模(実績台数/当社調査)



(図3)当社の半導体用製品ラインナップ

総代理店

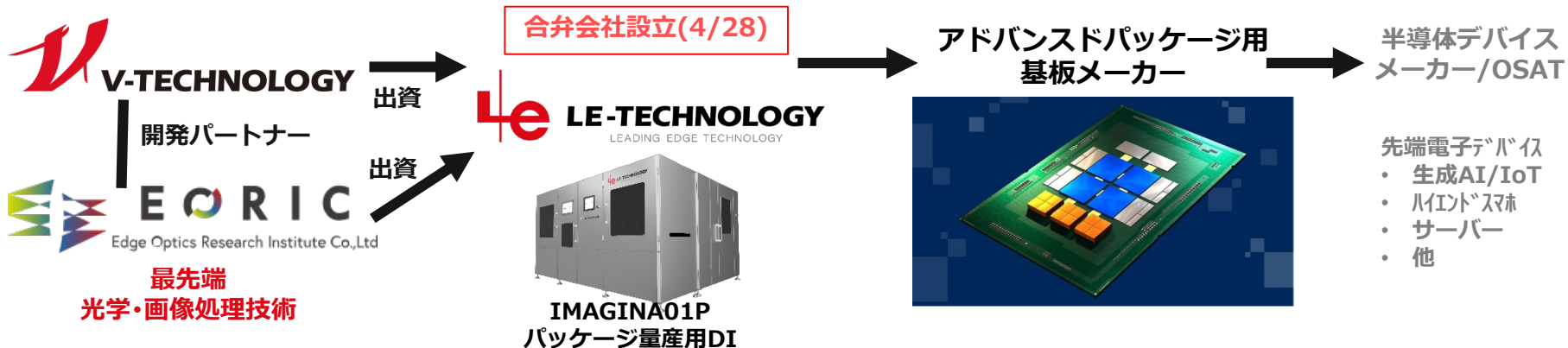


AOI Dione-CIS	Repair Draco	Repair Pictor	Repair CRS-400S/S+	Registration PMARS	2 nd layer writer StarkR6

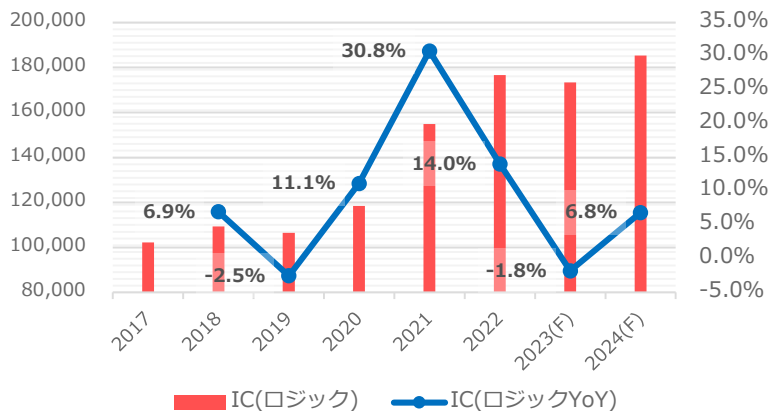
アドバンスドパッケージ用DI露光装置を受注

- ▶ 国内大手PCBメーカーより「IMAGINA01P」の受注を開始
- ▶ 半導体・ハイエンドCPU需要の回復が更なるDI露光の需要拡大を後押し

合併会社「LE-TECHNOLOGY」について



ロジックIC市場



半導体市場



注記事項

▶ 将来見通し

本資料に記載されている当社の計画、戦略、見通し及びその他の歴史的事実でないものは、将来に関する見通しであり、これらは現在入手可能な期待、見積、予想に基づいています。これらの期待、見積、予想は、経済情勢・市況の変化、競争環境の変化、顧客のある国の政策変化、係争中及び将来の訴訟の結果など多くの潜在的リスク、不確実な要素、過程の影響を受けますので、実際の業績は見通しから大きく異なる結果となる可能性があります。従って、これら将来予想に関する記述に全面的に依拠することは差し控えて頂きますようお願いいたします。また、当社は新しい情報、将来の出来事などに基づきこれらの将来予測を更新する義務を負うものではありません。

▶ 数字の処理

記載された金額は、単位未満を切り捨て処理、比率は単位金額で処理した結果を四捨五入している為、内訳と一致しない場合があります。

お問合せ先

社長室 IRグループ
vtj-mng-pre@vtec.co.jp

